

TectorFloor

POSADZKI CEMENTOWE



TectorFloor 470

Posadzka cementowa C20

Karta techniczna
Luty 2025



OPIS PRODUKTU

TectorFloor 470 Posadzka cementowa C20 jest podkładem podłogowym na bazie cementu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można stosować bez okładziny jako posadzkę wierzchnią. Klasyfikowany zgodnie z normą PN-EN 13813 jako podkład podłogowy CT-C20-F4-A22 oraz normą PN-EN 998-2:2002.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najlepsza jakość w swojej klasie – produkt podstawowy wyróżniający się doskonałą jakością.
- Klejenie płytek nawet po 4 dniach schnięcia**
 - pozwala na przyspieszenie prac i oszczędność czasu.
- Szeroki zakres stosowania – grubość warstwy 8–100 mm.
- Mrozoodporny – do stosowania na zewnątrz budynków.

** – TectorFloor 470 Posadzka cementowa C20 osiąga wilgotność pozwalającą na przyklejanie płytek ceramicznych po 4 dniach w przypadku zastosowania wody zarobowej w ilości 2,0 l/25 kg suchej mieszanki w normlanych warunkach aplikacji, tj. temperatura 18–22°C i wilgotność względna powietrza 55–65% i dla grubości podkładu do 50 mm.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania cementowych posadzek i podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, również bez konieczności montażu okładzin wierzchnich (posadzka cementowa) w klasie CT-C20-F4-A22* oraz do wykonywania warstw dociskowych i spadkowych na tarasach oraz balkonach:

- o grubości od 8 do 100 mm zespolonych z podłożem nośnym,
- o grubości od 35 do 100 mm na warstwie rozdzielczej,
- o grubości od 45 do 100 mm na warstwie izolacyjnej (tzw. podkłady pływające),
- o grubości od 60 do 100 mm (min. 45 mm nad rurką ogrzewania podłogowego) na wodne ogrzewanie podłogowe.

*sugerowane grubości dla pomieszczeń mieszkalnych.

Przy dobieraniu grubości jastrychu w poszczególnych technologiach, należy kierować się projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

Do stosowania pod okładziny z płytek ceramicznych, wykładzin, paneli, masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające i inne zaprawy cementowe.

Również do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PODKŁAD PODŁOGOWY ZWIĄZANY Z PODŁOŻEM

Podkłady podłogowe zespolone z podłożem nośnym wykonywane są bezpośrednio na płycie nośnej lub stropie. Podłoże pod aplikację podkładu związanego powinno charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, być czyste, pozbawione wszystkich luźnych części, olejów i smarów, które pogarszają przyczepność. W tym celu należy podłoże dokładnie oczyścić, odkurzyć i zagruntować. Podłoże powinno być wysezonowane do wilgotności resztkowej.

PODKŁAD PODŁOGOWY NA WARSTWIE ROZDZIELCZEJ

Podkład podłogowy na warstwie rozdzielczej jest oddzielony od podłoża nośnego warstwą materiału rozdzielającej np. folią polietylenową minimalnej grubości 0,2 mm. Na skutek zastosowania warstwy poślizgowej nie dochodzi do bezpośredniego połączenia jastrychu z podłożem, co sprawia, że każda z warstw pracuje niezależnie od siebie. Folia izolacyjna PE powinna mieć minimalną grubość 0,2 mm. Ułożenie jej powinno mieć zakład min. 100 mm połączony za pomocą taśmy przylepnej wodoodpornej tak, aby tworzyć tzw. szczelną wannę. Folia powinna być ułożona bez fałd. Dylatacja obwodowa (inaczej przyścienna) powinna być szczelnie połączona z warstwą rozdzielczą, a jej grubość powinna wynosić min. 5 mm dla jastrychów nieogrzewanych oraz 8 mm dla jastrychów z wbudowaną instalacją ogrzewania podłogowego.

PODKŁAD PODŁOGOWY NA WARSTWIE IZOLACYJNEJ

Podkład podłogowy na warstwie izolacyjnej potocznie również nazywany jest podkładem pływającym. Jest on układany na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej zabezpieczonej przeciwwilgociowo za pomocą folii polietylenowej 0,2 mm. Należy stosować wytyczne poniżej oraz wytyczne dla podkładu na warstwie rozdzielczej. Grubość warstwy izolacyjnej dobierana jest na podstawie wymagań projektowych. Wymagania dotyczące podłoża:

- w przypadku stosowania materiału izolacyjnego ze styropianu, jego wytrzymałość powinna być ≥ 70 kPa, chyba że stosowany jest styropian akustyczny,

- płyty styropianowe powinny zostać ułożone w sposób uniemożliwiający klawiszowanie, jak również tworzenie się pustek przy ścianach,
- nierówności podłoża przed ułożeniem materiału izolacyjnego powinny być $\leq 5\%$, mierzone za pomocą łaty 2-metrowej,
- maksymalna ściśliwość materiału izolacyjnego nie powinna przekraczać 5 mm we wszystkich warstwach;
- przy dużej grubości izolacji termicznej korzystniej jest ją układać w dwóch warstwach (w mijankę) w taki sposób, aby styki pomiędzy arkuszami materiału izolacyjnego nie pokrywały się ze sobą.

PODKŁAD PODŁOGOWY Z WBUDOWANĄ INSTALACJĘ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Podkład podłogowy wykonany jest na warstwie izolacyjnej w połączeniu z ogrzewaniem umieszczonym wewnątrz jego przekroju. Należy stosować wytyczne poniżej oraz wytyczne dla podkładu na warstwie rozdzielczej i na warstwie izolacyjnej. Przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu konstrukcji podłóg należy uwzględnić wiele szczegółów umożliwiających uzyskanie dobrze funkcjonującego systemu ogrzewania podłogowego. Do najistotniejszych należy wskazać: rodzaj ogrzewania, konstrukcję, eksploatację oraz wykończenie jastrychu. W trakcie wykonywania podkładu podłogowego na instalacji ogrzewania podłogowego należy pamiętać o tym, aby instalacja została wcześniej poddana próbie szczelności oraz była napełniona wodą pod odpowiednim, stałym ciśnieniem w trakcie prac.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Opakowanie wymieszać z czystą wodą w ilości 2,0–3,0 l/25 kg suchej mieszanki. Produkt należy mieszać przez 2–3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki pozbawionej grudek. Mieszankę należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania suchej mieszanki z wodą. Produkt można mieszać i pompować maszynowo.

Temperatura produktu, podłoża i powietrza powinna wynosić 5–30°C w trakcie stosowania.

WYKONANIE PODKŁADU

Mieszankę należy starannie zagęścić metodą odpowiednią do konsystencji np. poprzez ubijanie pacą lub stosowanie listew wibracyjnych. W podkładzie podłogowym należy odpowiednio zaplanować, a na-

stępnie wykonać szczeliny dylatacyjne. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych jak również sposób ich wykonania powinna określać dokumentacja techniczna, tak aby skutecznie wyeliminować naprężenia w płycie podkładu. Poszczególne pola dylatacyjne nie powinny przekraczać 20 m² na ogrzewaniu podłogowym i 25 m² bez ogrzewania podłogowego, a ich geometria powinna być zbliżona do kwadratu, przy czym proporcja boków nie powinny przekraczać 1:1,5. Świeżo wykonany podkład podłogowy należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem, utratą wilgoci i bezpośrednim działaniem słońca i wiatru.

DALSZE PRACE

- Ruch pieszy może odbywać się po 24 godzinach od wbudowania.
- Dalsze prace okładzinowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami i wskazówkami dostawców chemii budowlanej lub systemów budowlanych (np. dostawców klejów pod parkiety lub okładziny ceramiczne).
- Płytki ceramiczne można przyklejać już po 4 dniach**.
- Pełne obciążenie możliwe po uzyskaniu wytrzymałości, nie prędzej niż po 28 dniach dojrzewania.

** – TectorFloor 470 Posadzka cementowa C20 osiąga wilgotność pozwalającą na przyklejanie płytek ceramicznych po 4 dniach w przypadku zastosowania wody zarobowej w ilości 2,0 l/25 kg suchej mieszanki w normlanych warunkach aplikacji, tj. temperatura 18–22°C i wilgotność względna powietrza 55–65% i dla grubości podkładu do 50 mm.

Przed montażem dowolnej okładziny zaleca się badanie wilgotności resztkowej podkładu podłogowego. W przypadku podkładów podłogowych z wbudowaną instalacją ogrzewania płaszczyznowego montaż okładzin wierzchnich należy wykonywać po wygrzaniu podkładu i doprowadzeniu go do wilgotności resztkowej. Uruchomienie ogrzewania podłogowego można dokonać po 21 dniach od wbudowania produktu, a proces wygrzewania należy wykonywać zgodnie z instrukcją.

OPAKOWANIE

Produkt jest pakowany w worki 25 kg, po 56 worków na 1 palecie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku w danych warunkach i oryginalnym opakowaniu. Chronić przez wilgocią.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje na temat bezpieczeństwa w trakcie stosowania podane są na opakowaniu produktu oraz w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa dostępnej na stronie www.holcim.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55–60%. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP.

DANE TECHNICZNE

Zużycie produktu	1,8–2 kg/m ² /mm grubości
Wydajność z 1 worka suchej mieszanki	12,5–14,0 litrów
Zużycie wody	2,0–3,0 l/worek 25 kg
Czas mieszania	2–3 minuty do uzyskania jednorodnej masy
Czas zużycia	60 minut, w podwyższonych temperaturach czas może być krótszy
Temperatura obróbki	5–30°C
Grubość podkładów:	
- zespolonych z podłożem nośnym	8–100 mm
- na warstwie rozdzielczej	35–100 mm
- na warstwie izolacyjnej	45–100 mm
- na wodne ogrzewanie podłogowe	60–100 mm (min. 45 mm nad rurką ogrzewania podłogowego)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 20 MPa (C20)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 4 MPa (F4)
Odporność na ścieranie po 28 dniach	≤ 22 cm ³ /50 cm ² (A22)
Ruch pieszcy	Po 24 godzinach
Przyklejanie płytek ceramicznych	Po 4 dniach **

** – TectorFloor 470 Posadzka cementowa C20 osiąga wilgotność pozwalającą na przyklejanie płytek ceramicznych po 4 dniach w przypadku zastosowania wody zarobowej w ilości 2,0 l/25 kg suchej mieszanki w normlanych warunkach aplikacji, tj. temperatura 18–22°C i wilgotność względna powietrza 55–65% i dla grubości podkładu do 50 mm.